**2018台灣國際雷射展**

**「雷射工藝競賽」**

**參加辦法及報名表**

主辦單位：

台灣雷射科技應用協會

工業技術研究院

展昭國際企業股份有限公司

中華民國一○七年二月六日星期二

1. **活動目的**

雷射技術不只侷限於工業加工用途，亦可應用在生活的各個層面，並創作出美麗絕倫、充滿新意的工藝品。為使各界與全民同時認識雷射技術的軟應用與硬實力，主辦單位亦舉辦「雷射工藝競賽」,邀請對雷射工藝有興趣之民眾及相關從業人員參與比賽，讓社會大眾知曉雷射技術的廣泛應用。

1. **主辦單位**

台灣雷射科技應用協會

工業技術研究院

展昭國際企業股份有限公司

1. **贊助單位**

經濟部國際貿易局

Meet Taiwan

台北市政府觀光傳播局

1. **參加競賽產品類別**

使用雷射切割、焊接、表面處理等雷射相關技術之運用，或金屬3D列印製作之工藝品或文創藝術品。

1. **報名條件**
	1. 社會組：公司行號或非學生身份之個人/團體。
	2. 學生組：在學中之學生個人/團體，不限年齡。

 (註:報名時須提供學生證供辨識參賽資格)

1. **評審方式**

由主辦單位聘請國內雷射技術及設計相關之專家進行評選，取分數最高之前三名參賽者為今年競賽之得獎者。另開放現場投票，一位參觀者限投一票，取得票數高者則為今年競賽的「最佳人氣獎」。

1. **競賽時程表：**

繳交報名表：即日起至9月28日(五)止。

參賽作品寄送：

請於10月16日下午兩點親送至展覽現場布置，可現場自行挑選展位，並於展覽結束後自行領回。若無法親至現場，作品請於10月5日(五)前寄至以下地址並告知展後處理方式(例如:貨到付款方式退回或親至展昭公司領取)，並由大會安排展位。未告知作品後續處理方式之作品，將一律由主辦單位銷毀處理。

評審評選時間:10月17日於展覽現場評選。

票選時間:計票時間於10月17日(三)至10月18日(四) 下午五點。

得獎名單公布:10月17日(三)下午六點；最佳人氣獎將於10月18日(四)下午六點計票結束後公佈。

頒獎典禮:10月19日(五)。

作品撤展：10月19日(五) 下午五點後。

1. **報名方式**
	1. 時間:報名表請於107年9月28日(五)前繳交。
	2. 方式:E-mail報名，並請於郵件主旨註明「(姓名或公司名)\_報名2018年國際雷射
	 展–雷射工藝組」。
	3. 報名資料收件單位:

 展昭國際企業股份有限公司

 承辦人員:邱儷舒

 電話:02-26596000 分機361

 E-mail: cathy.chiu@chanchao.com.tw

* 1. 報名表下載: http://www.chanchao.com.tw/laserexpo/

**\*主辦單位將於收到報名表後3日內回覆確認，若未收到回覆，請主動來電詢問。**

1. **獎項及獎勵內容**

報名參加競賽之產品依現場票數統計評定，分別給予以下獎勵：

（一）社會組

特優(一名): 新台幣獎金一萬五千元整，獎狀乙張。

優勝(一名): 新台幣獎金八千元整，獎狀乙張。

佳作(數名): 獎狀乙張。

（二）學生組

特優(一名): 新台幣獎金一萬五千元整，獎狀乙張。

優勝(一名): 新台幣獎金八千元整，獎狀乙張。

佳作(數名): 獎狀乙張。

（三）最佳人氣獎

不分組別，現場得票數最高之作品獲勝，頒發獎狀乙張。

**\*票數相同時，則由主辦單位擇優選出。**

1. **注意事項**
	1. 作品無仿冒或侵害他人智慧財產權。
	2. 未完成之半成品及難以移動、搬運，或是容易破碎、變質、變形及不耐久存之作
	 品，不得參加。作品如因損壞致無法進行評選，工藝中心得逕取消其資格且不負賠
	 償責任。
	3. 參賽作品規格長、寬、高，以不超過97×47×45公分為原則。
	4. 作品中如有配件是購買而得、非作者親自製作，亦須詳加註明。
	5. 所有參賽作品若有電力及額外照明等特殊需求，請於報名時提出。未事先提出需求
	 者，展示現場概不受理。
	6. 本主辦單位得運用獲獎之新產品之資料作為展示、攝影及出版等用途。
	7. 本辦法若有未盡事宜得隨時修訂之並於官網公告。

**附件一、報名表**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.參賽者名稱 |  |
| 2.聯絡人姓名 |  |
| 3.聯絡地址 |  |
| 4.聯絡電話 |  |
| 5.E-mail |  |
| 6.參賽組別 | [ ]  社會組[ ]  學生組(報名時請檢附學生證正反面影本) |
| 7.作品名稱 |  |
| 8.作品簡介 (約150字) |  |
| 9.作品照片 | 含正面、側面、上面與立體視角，共四張。請以附件方式夾帶解析度300dpi以上之電子圖檔 |

註:報名表格可自行調整大小

**附件二、切結暨同意書**

1. 茲切結本人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_報名參賽作品\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(作品名稱)，確實屬本人之作品。本人擁有版權，無侵害他人著作權或其他權利之情事。若有使用他人作品或資料之部分，也已取得版權所有者之授權，並無抄襲、剽竊及隱瞞等情事。如有侵害他人智慧財產權或有任何其他違法情事，因而引發糾紛或訴訟，願自負相關法律責任，並退回獎項之獎座及獎金等競賽獎勵。
2. 本人參加「2018台灣國際雷射展 – 雷射工藝競賽」，已詳細閱覽並同意遵守主辦單位所規定之各項注意事項。
3. 本人同意無償授權主辦單位三年使用年限，得因推廣或行銷活動之目的將作品照片使用於相關行銷媒體。

**此致**

**主辦單位**

**立切結書人（簽名並蓋章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿**

**日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿**